



推奨基板取付け寸法 (非累積公差)  
 RECOMMEND PC BOARD HOLE (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
 PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1  
 基板厚: 1.6±0.1

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, UL94V-0  
 CONTACT: COPPER ALLOY  
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性樹脂, UL94V-0  
 コンタクト: 銅合金  
 リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト接触部: ニッケル下地の上に金めっき 0.38μm MIN
- めっき: コンタクト接触部: ニッケル下地の上に金めっき 0.76μm MIN
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
 接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
 : ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
 : ニッケル下地の上にスズめっき

△6 △4	↑	-5
△6 △3		-3
△6 △2		316517-2
FINISH	型番	PART NUMBER

Copyright ©1995 年		Copyright ©1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
B REVISED (FJD0-0039-03)		TS J.M. 10/25		DYNAMIC (D-3500) 20 POS. V HDR. ASS'Y	
A REVISED (FJD0-0114-03)		TS SM 10/25		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.35 10mm超 3mm以下: ±0.4 30mm超 100mm以下: ±0.45 角 度: ±3'	
O RELEASED FJ00-3261-95		NM Y.I. 10/24		尺 度 (SCALE) 2/1	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR CHK DATE		番号 (No.) C-316517	
		CHK. Y. ISHIKAWA		図 号 (SCALE) B	
				SHEET 1 OF 1	

NUMBER 316517  
 METRIC  
 PROJ NO. 395-623  
 単位: 寸 寸法 IN MM. DO NOT SCALE PRINT  
 PRINT DIST  
 AMP-J  
 REV. 10/93

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[316517-3](#)